

第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウム開催案内

Ver.1

主催 日本材料学会・複合材料部門委員会, SAMPE Japan・コンポジット委員会, 同志社大学・先端複合材料研究センター

<開催趣旨> sustainable 社会の構築にむけ、自動車には低燃費化に向けた重大な課題達成が求められています。今後一段と厳しくなる CO₂ 排出規制に対応するためには、炭素繊維を中心とした強化繊維を用いた複合材料を、車体に適用していることが必須課題となると推定されます。しかしながら、未だ、複合材料を用いた車体の量産化に求められる新しい技術開発課題は多く、現在なお、その実現のプロセスは明確にされていません。その解決の糸口は、さまざまな技術者・研究者が交流し、さまざまな視点から討論することにより、紡ぎだされるものと考えます。

2009 年から毎年開催しております「自動車用途コンポジットシンポジウム」も、今年で第 11 回を迎えることになりました。関連の分野に関心をお持ちの方々や関係される多数の方々の積極的なご参加をお待ちしております。

開催日 2019 年 11 月 15 日(金) 10:15~19:00

会場 同志社大学 (今出川校地) 寒梅館地下 ハーディーホール, クローバーホール
〒602-0023 京都市上京区烏丸上立売下ル

参加費 一般: 20,000 円
共催・協賛会員: 10,000 円
学生: 3,000 円
テーブルトップ: 30,000 円 (1 名分のシンポジウム参加費用含む)
お支払方法: シンポジウム当日, 受付にて現金でお支払いをお願いします。

<プログラム(暫定版)>

最終版は、同志社大学・先端複合材料研究センターの HP をご覧下さい。

<http://rdccm.doshisha.ac.jp>

開会挨拶 (10:15~10:20) シンポジウム実行委員長 田中和人(同志社大)

<海外技術紹介(1)[JEC2019]> (10:20~11:20)

GS-01 JEC2019: 熱可塑性複合材料技術の見どころ(仮) 山根正睦 (福井大学)

<昼食> (11:20~12:00)

<ポスター:ショートオーラル・セッション> (12:00~13:30)

[約 25 篇, 近日, ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載予定]

<海外技術紹介(2)[K2019]> (13:30~15:30)

GS-02 K 2019 国際プラスチック・ゴム産業展における成形装置の動向

倉谷 泰成((株)KADO)

GS-03 K 2019 国際プラスチック・ゴム産業展における自動車用途コンポジット

田中和人 (同志社大学)

GS-04 (調整中)

<休憩> (15:30~15:40)

<ポスターセッション> (15:40~16:30)

[約 25 篇, 近日, ホームページ <http://rdccm.doshisha.ac.jp> に掲載予定]

<一般講演> (16:30~17:20)

GS-05 高温高強度 ZrB2/B4C コンポジットの作製

○廣田健 (同志社大), Le Tung Duy, 加藤将樹, 湯浅元仁,
宮本博之, 西村聡之 (物質・材料研究機構)

GS-06 オートクレーブ法を使わない新規成形法

○辻村豊 (播羊化学研究所), 鳥山倫靖 (MONOPOST)

閉会挨拶 (17:20~17:25)

先端複合材料研究センター長 田中達也(同志社大)

情報・名刺交換会 (17:30~19:00) Hamac de Paradis(アマーク・ド・パラディ) 寒梅館 1階カフェレストラン

<各種締め切り>

- ・テーブルトップ展示申込期限 (先着 5 社まで) : 2019 年 11 月 1 日 (金)
- ・シンポジウム・情報・名刺交換会参加申込締め切り : 2019 年 11 月 1 日 (金)

<各種問い合わせ先>

同志社大学・先端複合材料研究センター : rdccm@mail.doshisha.ac.jp
あるいは実行委員長 田中和人 : ktanaka@mail.doshisha.ac.jp
まで、ご連絡下さい。

<最終プログラム>

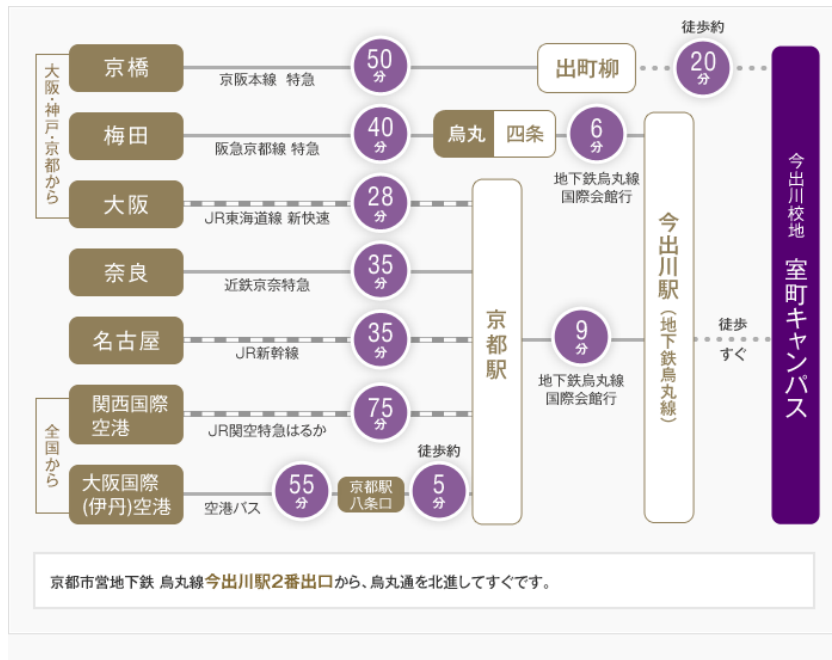
同志社大学・先端複合材料研究センターの HP をご覧下さい。

<http://rdccm.doshisha.ac.jp>

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>





お申し込み方法: E-mail あるいは fax にて下記の内容をご送付下さい。

第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウム 参加申込用紙

同志社大学・先端複合材料研究センター事務局 行
 E-mail: rdccm@mail.doshisha.ac.jp
 FAX: 0774-65-6784

シンポジウム・懇親会参加申込締め切り: 2019 年 11 月 1 日(月)

- ・第 11 回 自動車用途コンポジットシンポジウムに参加します。
- ・情報・名刺交換会(参加費は無料。)に【参加します. 参加しません.】

[いずれかを消して下さい]

会社名: 所属:
 郵便番号: TEL:
 住所: FAX:
 氏名: E-mail: